



# 深度\*行业\*电子行业周报：全 球半导体市场高增 智能终端 迎密集发布期



本周 SW 电子行业指数上涨 0.70%，电子行业指数跑赢沪深 300 指数 0.83 个百分点，在所有一级行业中排序 9/28。各子行业涨跌幅：半导体材料 (4.74%)、被动元件 (3.17%)、集成电路 (2.31%)、分立器件 (2.12%)、电子零部件制造 (2.07%)、LED (1.25%)、其他电子Ⅲ (0.74%)、印制电路板 (0.55%)、光学元件 (0.22%)、电子系统组装 (-2.19%)、显示器件Ⅲ (-3.50%)。截至本周收盘，电子行业 PE-TTM 为 37.19 倍。

### 支撑评级的要点

行业动态：1) 英特尔亚利桑那州 Fab52、Fab62 晶圆厂动工。新晶圆厂规划总投资额 200 亿美元，预计将于 2024 年投产，建成后将支持英特尔自身产品不断成长的需求，同时也为英特尔代工服务提供产能。新晶圆厂将生产英特尔最先进的制程技术，包括采用全新 RibbonFET 和 PowerVia 创新技术的英特尔 20A (2nm) 工艺。2) 全球晶圆代工市场规模今年将超 1000 亿美元。ICInsights 最新数据，预计 2021 年全球代工销售额将达到 1072 亿美元，增长 23%，追平 2017 年增长率纪录，并继续以强劲的 11.6% 的速度增长，到 2025 年将达 1512 亿美元。3) 台积电 SoIC 厂房将于今年导入机台，2.5D 先进封装厂房预计明年完成。9 月 23 日，台积电先进封装技术暨服务副总经理廖德堆在线上高科技智能制造论坛上表示，台积电正在竹南建设 3DFabric 先进封测制造基地。3DFabric 平台整合先进测试、SoIC 和 2.5D 先进封装等先进封测技术，能提供 5nm 以下小芯片整合解决方案。其中，SoIC 厂房将于今年导入机台，2.5D 先进封

装厂房预计明年完成。4) 华为发布 nova9 系列。2021 年 9 月 23 日，华为召开新品发布会，发布 nova9 系列智能手机、MatePad11、WtatchFit、Freelace 无线耳机、华为 AI 音箱 2e 和华为氮化镓超薄充电器，同时宣布，HarmonyOS2 升级用户突破 1.2 亿，成为全球用户量最快破亿的移动操作系统。本周发布的新机还有，微软发布第二代折叠屏手机 SurfaceDuo2，魅族发布魅族 18s 系列、魅族 18X 智能手机。5) 华为发布 openEuler 欧拉操作系统。华为于 9 月 23 日至 9 月 25 日在线上举办以“深耕数字化”

为主题的华为全联接 2021 大会，会上华为副总裁、计算产品线总裁邓泰华宣布正式发布欧拉开源操作系统首个全场景版本。华为重点打造的两个操作系统鸿蒙+欧拉，可以覆盖各种场景，鸿蒙是面向万物互联的智能终端操作系统，欧拉是面向数字基础设施的开源操作系统。

建议关注：

IC 设计：韦尔股份、圣邦股份、北京君正、卓胜微、芯朋微、艾为电子、恒玄科技等

功率半导体：华润微、士兰微、捷捷微电、新洁能等 IC 制造：中芯国际、华虹半导体（港股）

IC 封测：长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等消费电子：立讯精密、歌尔股份、环旭电子、欧菲光等

风险提示：

海外疫情控制不及预期;半导体景气度不及预期;终端需求不及预期。

关键词: LED 氮化镓 疫情 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_27093](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27093)

